

Template for Physical System Specification  
180424

表題

- ・「仕様書名（書番：）」
- ・「プロジェクト名（プロジェクト番：）」

更新履歴

筆頭作成者およびプロジェクト責任者  
プロジェクトチーム編成と役割ツリー図

0、開発仕様抜粋

（開発仕様書「仕様書名（書番：）」に下位準拠）

- ・完成品概要と総システム概要
- ・代表特性
- ・目標コスト、目標組立時間
- ・計画線表

1、適用

本仕様書は「品名（部番：）」完成品および該完成品に含む仕掛品に関する。  
また、「品名（部番：）」の完成品類型「品名（部番：）」の完成品および該完成品に含む仕掛品に関する。

2、インターフェース構成

インターフェース総ブロック図（含隣接インターフェース品名・部番）

外部インターフェース構成

- ・機械的インターフェース
  - ・・機械的外観形状（含機械連結）
  - ・・電気端子配置形状
  - ・・光学要素配置形状
- ・電氣的インターフェース
  - ・・電気端子ピンアサイン表
- ・光學的インターフェース
  - ・・光路図形状（含光学設計図面）
  - ・・光学的入出力端子形状

3、条件

機械的条件

- ・動作時振動姿勢曝露条件
- ・保存時振動姿勢曝露条件

電氣的條件

- ・入力端子駆動条件
- ・出力端子負荷条件
- ・入出力端子タイミング条件

光學的條件

- ・光学的入出力端子取扱条件

温湿度条件

- ・動作時温湿度条件
- ・保存時温湿度条件
- ・コールドスタート条件

#### 4、特性

##### 機械的特性

##### 電気的特性

- ・入力端子応答特性
- ・出力端子駆動特性
- ・入出力端子タイミング特性

##### 光学的特性

##### 耐久動作特性

- ・間欠動作時間
- ・連続動作時間

#### 5、梱包仕様

- ・完成品梱包仕様
- ・仕掛品梱包仕様

#### 6、検査方法

##### 完成品検査方法

##### 仕掛品検査方法

##### 梱包品検査方法

##### 熱試験方法

- ・低温動作試験方法
- ・低温放置試験方法
- ・高温動作試験方法
- ・高温放置試験方法
- ・熱サイクル負荷試験方法

#### 7、付録

- ・親システム仕様書（参考）
- ・子システム仕様書（参考）

###